

Technisches Merkblatt des Produkts

Wärmeleitpaste HPX

Wärmeleitende HPX Paste mit einem Koeffizient der thermischen Wärmeleitfähigkeit $>2,8\text{W/mK}$, die keinen elektrischen Strom leitet. Für den korrekten Betrieb aller Arten von Temperatursensoren notwendig ist. Niedrige thermische Impedanz der Paste ermöglicht das Behalten einer festen Wirksamkeit bei Temperaturen von -50 bis 250°C .

Anwendung:

Module mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit,
 Kühlungsgerät auf den Endplatten und Rahmen,
 Speicherlaufwerke und Hochgeschwindigkeitslaufwerke,
 Motorsteuerungssysteme (Automobilindustrie),
 Festplattenlaufwerke und DVD,
 Stromrichter,
 LED Dioden mit einer großen Leistung,
 Notebooks und Bürocomputer,
 Netzwerkkommunikationsgeräte,
 Haushaltsgeräte, elektrische und elektronische Komponente,
 Klimaanlage.

Physikochemische Eigenschaften:

Parameter	Einheit	Ergebnis
Farbe	-	grau
Wärmeleitfähigkeit	W/mK	$> 2,8$
thermische Impedanz	$^\circ\text{C in}^2/\text{W}$	$< 0,095$
spezifisches Gewicht	g/cm ³	2,0
Verdampfen	-	0,001
Überlaufen	-	0,05
Dielektrizitätskonstante	-	5,1
Viskosität	-	fließt nicht
Thixotropiezahl	-	380+/-10
Beständigkeit gegen Temperatureinwirkung	$^\circ\text{C}$	$-50 \sim 300$
Arbeitstemperatur	$^\circ\text{C}$	$-50 \sim 250$

Verpackungen:

Volumen	Art der verpackung	Sammelverpackung	Artikelcode
60 g	Kartusche	5	ART.AGT-126
100 g	Kunststoffbox	6	ART.AGT-128
1 kg	Kunststoffbox	1	ART.AGT-114
7 g	Tube	10 / 300	ART.AGT-275

Lagerung:

An einem gut belüfteten, kühlen, trockenen Ort lagern. Behälter, falls diese nicht gebraucht werden, dicht verschlossen lagern. Vor direktem Sonnenlicht schützen.